

2026년도 「고신뢰 반도체 상용화를 위한 검증·확인 지원」 사업 기업 지원 프로그램 모집 2차 공고

한국팹리스산업협회(KFIA)는 경북대학교, 한국산업기술시험원과 함께 산업통상자원부가 주관하고 있는 고신뢰 반도체 상용화를 위한 팹리스 검사·검증의 일환으로 『고신뢰 반도체 상용화를 위한 검증·확인 지원』을 수행하고 있으며, 관련 기업 대상으로 기업지원사업을 시행하고 있습니다. 아래와 같이 기업지원 및 전문인력양성 사업 2차 공고를 진행하오니, 희망하는 비수도권 소재의 팹리스 기업의 많은 신청 바랍니다.

2026. 04. 30
한국팹리스산업협회 회장

○ **사업목적**

☞ 비수도권 팹리스 검증·확인 거점 기반을 확보하고 전용공간 및 기업 지원 환경 구축

○ **사업내용**

- ☞ (센터 구축) 팹리스 기업의 고신뢰 반도체 개발 지원을 위한 V&V 지원 센터 구축
- ☞ (장비/툴 지원) 반도체 V&V 지원 장비 및 툴 구축
- ☞ (개발 및 상용화 지원) 고신뢰 반도체 개발 및 상용화 지원
- ☞ (생태계 활성화 지원) 고신뢰 반도체 생태계 활성화 지원

○ **사업기간** : 2025. 5. 01. ~ 2029. 12. 31.

○ **당해연도** : 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. (2차년도)

○ **문의처**

기관	담당자	E-mail	문의
한국팹리스산업협회(KFIA)	강영석 PM	kfia.kang@gmail.com	053-214-9890
	최민서 PM	kfia.cms@gmail.com	

지원내용

가. 기술지원분야

프로그램	지원내용	최대 지원 비용	비고										
시제품 제작 지원 (2건)	<ul style="list-style-type: none"> • 시제품 제작 지원 - 국내 팹리스 업체가 개발하는 반도체 및 이의 검증 과정과 상용화를 위한 과정에 필요한 모듈, 보드, 제품 등의 검증·확인 관련 시제품 제작 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>내 용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지원 기간</td> <td>- 협약 체결일로부터 5개월 ('26년 6월 ~ 11월)</td> </tr> <tr> <td>지원 방식</td> <td>- 간접(비용)지원 (선정기업과 계약한 업체에 직접지급) - 고신뢰 반도체 검증지원센터 장비 활용 필수</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	내 용	지원 기간	- 협약 체결일로부터 5개월 ('26년 6월 ~ 11월)	지원 방식	- 간접(비용)지원 (선정기업과 계약한 업체에 직접지급) - 고신뢰 반도체 검증지원센터 장비 활용 필수	15,000 천원	기업부담금 10%이상				
구 분	내 용												
지원 기간	- 협약 체결일로부터 5개월 ('26년 6월 ~ 11월)												
지원 방식	- 간접(비용)지원 (선정기업과 계약한 업체에 직접지급) - 고신뢰 반도체 검증지원센터 장비 활용 필수												
고신뢰 반도체 검증지원센터 장비 활용	<ul style="list-style-type: none"> • 고신뢰 반도체 검증지원센터 장비 활용 - 시제품 제작지원 프로그램과 연계 진행 시 고신뢰 반도체 검증지원 센터 활용 장비 사용료 할인 지원 - 반도체 디지털 회로 설계 소프트웨어, 반도체 복합회로 설계·검증 소프트웨어, 반도체 아날로그 설계 소프트웨어, Haps-100 4s, pro FPGA 등 <p>* 보유 장비 확인 : cisdaegu.kr 또는 구글 : '지능형반도체개발지원센터' 입력</p>	장비 사용료 할인	시제품 제작 신청 시 필수										
마케팅 지원 (5건)	<ul style="list-style-type: none"> • 고신뢰 반도체 홍보물 제작 지원 <table border="1"> <thead> <tr> <th>지원항목</th> <th>지원내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>홍보영상</td> <td>• 제품 및 기술 홍보 목적의 영상 제작 - 제품의 기능적·기술적 특징점 소개, 기술 및 제품 활용법 콘텐츠 등 다회성 영상 제작 비용</td> </tr> <tr> <td>브로셔</td> <td>• 고객사 또는 바비어에게 제품 및 기술에 대한 상세 정보를 제공하기 위한 브로셔 제작</td> </tr> <tr> <td>소개 페이지</td> <td>• 웹 또는 모바일 환경에서의 제품 및 기술 소개 페이지 제작 (홈페이지, 랜딩페이지, 모바일 커머스 등)</td> </tr> <tr> <td>기타 마케팅</td> <td>• 신청기업의 마케팅 전략에 맞는 다양한 홍보물 제작 제안 가능(선정평가 후 확정) - 홍보물 제작 범위 내에서 직접적 관련성 필요 ※ 물품구매, 인건비·여비 등 소모성 경비, 리플렛, 전단지/ X-배너 등 일회성 및 답례품 성격 물품 불가</td> </tr> </tbody> </table>	지원항목	지원내용	홍보영상	• 제품 및 기술 홍보 목적의 영상 제작 - 제품의 기능적·기술적 특징점 소개, 기술 및 제품 활용법 콘텐츠 등 다회성 영상 제작 비용	브로셔	• 고객사 또는 바비어에게 제품 및 기술에 대한 상세 정보를 제공하기 위한 브로셔 제작	소개 페이지	• 웹 또는 모바일 환경에서의 제품 및 기술 소개 페이지 제작 (홈페이지, 랜딩페이지, 모바일 커머스 등)	기타 마케팅	• 신청기업의 마케팅 전략에 맞는 다양한 홍보물 제작 제안 가능(선정평가 후 확정) - 홍보물 제작 범위 내에서 직접적 관련성 필요 ※ 물품구매, 인건비·여비 등 소모성 경비, 리플렛, 전단지/ X-배너 등 일회성 및 답례품 성격 물품 불가	10,000 천원	
지원항목	지원내용												
홍보영상	• 제품 및 기술 홍보 목적의 영상 제작 - 제품의 기능적·기술적 특징점 소개, 기술 및 제품 활용법 콘텐츠 등 다회성 영상 제작 비용												
브로셔	• 고객사 또는 바비어에게 제품 및 기술에 대한 상세 정보를 제공하기 위한 브로셔 제작												
소개 페이지	• 웹 또는 모바일 환경에서의 제품 및 기술 소개 페이지 제작 (홈페이지, 랜딩페이지, 모바일 커머스 등)												
기타 마케팅	• 신청기업의 마케팅 전략에 맞는 다양한 홍보물 제작 제안 가능(선정평가 후 확정) - 홍보물 제작 범위 내에서 직접적 관련성 필요 ※ 물품구매, 인건비·여비 등 소모성 경비, 리플렛, 전단지/ X-배너 등 일회성 및 답례품 성격 물품 불가												

프로그램	지원내용	최대 지원 비용	비고
	<ul style="list-style-type: none"> • 국내·외 반도체 전시회 공동관 참가 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 참여 기관과의 공동 전시회 참가를 통해 참가 기업의 전시 제품의 특성을 고려한 공동관 내 독립 전시부스 구축 	현물	공동관 참여기업 별도 모집
	<ul style="list-style-type: none"> • 국내·외 반도체 전시회 참가 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 시장 진출을 목적으로 참가하고자 하는 국내·외 반도체 관련 전시회 참가 	10,000 천원	

나. 인력양성분야

프로그램	지원내용	최대 지원 비용	비고
전문인력양성	<ul style="list-style-type: none"> • 검증·확인(V&V) 전문 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 비수도권 팹리스 기업 재직자 및 관련 종사자를 위한 실무 중심의 맞춤형 교육 실시 - 장비 활용 전문 인력 양성 교육 	무상	

※ 교육 일정 및 교육 내용은 수요자와 조율(위치, 교육 기간 등)하며 교육 실시

지원 자격 및 우대사항

가. 지원자격

- **고신뢰 반도체 설계 기업**(팹리스, IP 전문 기업 등)으로 중소기업* 및 중견기업*(창업 및 벤처기업 포함)이며, 다음 ①, ② 요건 중 하나라도 해당하는 기업
 - ① 비수도권(서울·인천·경기·해외 제외) 내 본사, 지사, 공장, 연구소 중 1개 이상 소재한 기업
 - ② 수도권 기업 중 '26년까지 (대구)지능형 반도체 개발지원센터 입주 예정*인 기업
 - * 입주확약서 제출 필수
- 신청기업이 설계한 제품으로, 2026년 협약 기간 내 프로그램 완료가 가능한 기업
- 본 지원프로그램의 목적 및 취지에 부합하는 국내 반도체(팹리스) 기업

* 중소기업기본법 제2조 및 중소기업시행령 제3조(중소기업의 범위)에 해당하는 중소기업

* 중견기업성장촉진 및 경쟁력강화에 관한 특별법 제2조 해당하는 중견기업

나. 우대사항

우대사항	우대조건	가 점
지역우대	- 지능형 반도체 개발지원센터 입주 기업	5점

다. 유의사항

- 프로그램에는 기업부담금(부가세 별도)이 있으며, 결과보고서 제출시 기업부담금 증빙 내역(이체확인서 등) 제출 필수
- 지원금은 평가결과에 따라 조정될 수 있으며, 사후정산방식으로 운영됨(결과보고서 제출 후 공급기업에게 지급)
- 제출된 서류는 일체 반환하지 않음
- 신청기업의 단순 포기 등으로 인한 사업 중단 시 차회 신청에 제한이 있을 수 있음

가. 신청 및 접수

- 한국팹리스산업협회 홈페이지(www.k-fabless.com)에서 공고문 확인
- 공고문 내 첨부 신청서 양식을 다운로드하여 작성 후 이메일 제출
- 접수방법 : 제출서류를 모두 구비하여 이메일 (kfia.cms@gmail.com) 제출
 - ※ 제출 후 필히 '접수 확인 메일' 확인

나. 신청기간

- 2026년 4월 30일(목) ~ 5월 22일(금), 18:00까지
 - ※ 예산 소진에 따라 조기마감 가능

다. 제출서류

번호	서류명	부수	제출	비고	형태	접수방법
1	지원신청서(원본) ※ 관련 견적서 포함(별첨 참고)	1부	필수	지정서식	전자파일 (HWP)	이메일
2	지원신청서(날인본), 장비 사용 신청서 (시제품 제작 지원 시)	1부	필수		전자파일 (PDF)	
3	사업자등록증 사본 (지사, 연구소 별도 제출)	1부	필수	-	스캔본 (PDF)	
4	최근 3년(2023 ~2025) 재무제표	1부	필수			
5	국세·지방세 완납증명서	1부	필수			
6	지능형 반도체 개발지원센터 입주계약서(혹은 입주예정서)	1부	해당시	우대사항		

○ 서류제출 시 유의사항

- 신청서의 성실한 작성도 평가항목이므로 예시 및 작성요령에서 제시한 사항 (파란 글씨)을 참고하여 성의있게 작성
- 제출서류가 위.변조 혹은 허위임이 밝혀질 경우 그 즉시 선정 취소 또는 협약이 해약되므로 사실대로 작성하여 제출할 것
- 기타 추가 증빙서류는 본 과제와 관련하여 추가로 제출하고자 하는 서류가 있을 경우만 제출(ex. 사업장 이전 확인서, 관련 특허증, 수상이력 등)
- 서류제출 시 파일명에 순번과 서류명, 신청기업명 기입
(ex. 3_사업자등록증 ((주)기업명.pdf)

라. 평가방법 및 기준

o 1단계 : 서류검토

- 결격사유 및 자료 미제출 등 검토

o 2단계 : 전문가 평가(필요 시 발표평가)

- 산·학·연 전문가 5인 내외로 구성된 평가위원을 통해 선정
- 필요 시 서류통과 기업은 발표평가 진행에 필요한 발표자료(PPT) 제출, 평가일정 및 방법은 개별 안내

o 3단계 : 결과 발표

- 선정평가 결과는 개별 통보하며, 평가결과는 원칙적으로 공개하지 않음

가. 지원제외 처리기준

- 타 정부과제 중복지원 불가(동일 건으로 중복지원 불가)
- 신청기업이 지원사업의 목표, 취지에 부합하지 않는 경우(외국계기업의 국내법인 등)
- 접수마감일 현재 신청기업이 국가연구개발사업에 참여제한을 받고 있는 경우
- 접수마감일 현재 신청기업이 아래의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 기업의 부도
 - 세무당국에 의하여 국세, 지방세 등의 체납처분을 받은 경우(단, 회생인가 받은 기업, 중소벤처기업진흥공단 등으로부터 재창업자금을 지원받은 기업은 예외)
- 접수기간 내에 사업계획서 등의 서류 제출이 미비한 경우

나. 사업 선정 시 성과 활용 동의 필요

- 매출 성과 활용 조사 동의 : 기업지원 혹은 인력양성사업에 선정된 기업의 경우, 지원받은 제품과 관련하여 직간접적으로 창출된 매출 조사에 적극적인 협조 필요
- 고용 창출 성과 활용 조사 동의 : 기업지원 혹은 인력양성사업에 선정된 기업의 경우, 지원받은 제품과 관련하여 직간접적으로 창출된 매출 조사에 적극적인 협조 필요
- 본 사업과 연계된 네트워킹 활동(기술세미나, 협의체, 워크숍 등) 적극 협조 요청